



8440 HS

Toote Teave

40 µm läbikumav HAF-paigaldusteip

Toote kirjeldus

tesa® HAF 8440 on termiliselt aktiveeritav kahepoolne läbikumav kile, mis põhineb termoplastsel kopolüamiidil.

- Eriomadused
- * Kiipmoodulite usaldusväärsed liimühendused
- Sobib PVC-, ABS- ja PC-kaartide korral
- Hea töödeldavus kõikidel tavapärasel koosteliinidel
- Hea vananemiskindlus
- Ei ole koostatud kaardil nähtav

Funktsioonid

- Reliable chip module bonding
- Suitable for PVC, ABS and PC cards
- Good workability on all common implanting lines
- Good ageing resistance
- Invisible on assembled card

Rakendused

tesa® HAF 8440 on spetsiaalselt välja töötatud kiipmoodulite sisestamiseks kiipkaartidesse.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------|--------------------|-----------|
| • Põhimiku materjal | ei | • Kattepaberi tüüp | pärgamiin |
| • Liimi tüüp | kopolüamiid | • Kogupaksus | 40 µm |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | |
|--------------------|----------------------|
| • Ühenduse tugevus | 12 N/mm ² |
|--------------------|----------------------|

Lisateave

Tehnilised soovitused

- alustades kasutage parameetrite järgmisi soovituslikke väärtusi. Arvestage, et optimaalsed parameetrid olenevad suurel määral masina tüübist, auto keres kasutatud materjalidest ning kiipmoodulitest, samuti kliendi nõuetest.
- 1. Eelnev lamineerimine
- lamineerimise ajal kaetakse moodulivöö kleeplindi kihiga. Seda etappi võib teha kas masinkooste abil või autonoomselt. Eelnev lamineerimine ei mõjuta kleeplindi säilivusaega.
- Masina seadistus

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=08440>



8440 HS

Toote Teave

Lisateave

- Temperatuur: 130–140 °C
- Surve: 2–3 bar
- Aeg: 1,5–2,5 m/min
- 2. Mooduli sisestamine
- sisestamise ajal stantsitakse eellamineeritud moodulid moodulivööst välja, positsioneeritakse kaardi süvendi kohale ning temperatuuri ja surve abil tagatakse püsiv liimühendus kaardiga. Selles etapis oleneb täpne käitlemine kasutatavast koosteliinist. Kasutada võib nii ühe- kui ka mitmeetapilist meetodit. Tänapäeval on tavapärane mitmeetapiline meetod.
- Üheetapiline protsess – masina seadistus
- Temperatuur1: 180–220 °C
- Surve: 65 N/moodul
- Aeg: 1,5 s
- Mitmeetapiline protsess (2 või enam kuumstantsi) – masina seadistus
- Temperatuur1: 180–220 °C
- Surve: 65 N/moodul
- Aeg: 2 × 0,7 s / 3 × 0,5 s
- 1 Temperatuur on mõõdetud kuumpressi templis. Eri materjalist kaartide korral soovime kasutada eri temperatuure.
- PVC: 180–190 °C
- ABS: 180–190 °C
- PET: 190–200 °C
- PC: 200–220 °C
- Kiipmoodulite koostetoimingust erineva kasutuse korral tuleb masinal kasutada erinevaid parameetreid.
- tugevus saadi standardsetes laboritingimustes. Väärtus on lubatud vahemikus ja seda kontrollitakse iga tootepartii puhul (materjal: söövitatud alumiiniumist proovikeha / liimühenduse tingimused: temp. = 120 °C; p = 10 bar; t = 8 min).
- Ladustamistingimused peavad vastama tesa® HAFi säilivusaja kontseptsioonile.

Tagastamine

tesa® tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=08440>